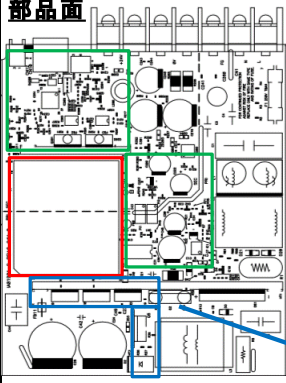
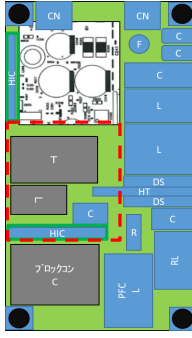
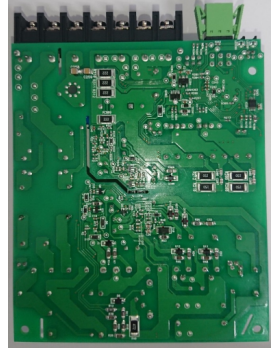
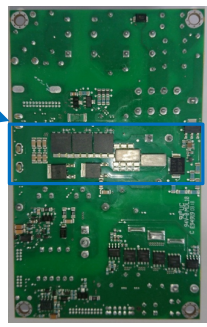


区分/ 工法 展示No	区分: ☐ 電動化 ☐ 軽量・小型化 ☐ 環境寄与 ☐ 自動運転・安全 ☐ 原価低減・品質向上 ☒ その他の技術分野			
	工法: ☐ 部品加工() ☐ 表面処理 ☐ 素材/材料 ☐ 設備/装置 ☐ 金型/治工具 ☐ システム/ソフトウェア ☐ デザイン ☐ 自動化技術 ☒ その他(回路・構造設計技術)			
提案名		工法	新規性	
最適設計による祈願の小型化		電源開発	独自技術	
会社名	所在地			
(株)三社電機イースタン	〒391-0213 長野県茅野市豊平5335			
連絡先	URL			
部署名: 営業部 開発営業	: https://www.est.sansha.co.jp			
担当名: 藤森 昭人	Tel No.: 0266-82-6605			
主要取引先	E-mail: a_fujimori@est.sansha.co.jp			
・富士通株 ・文化シャッター株 ・富士電機製造株	・日本電機株 ・株GSユアサ ・蛇の目マシン工業株 他	海外対応	☒ 可 (生産拠点国を記入 中国) ☐ 否	

<< 提案内容 >>

提案の狙い		適用可能な製品/分野			
☐ 電動化 ☐ 環境寄与/対策 ☐ 原価低減 ☐ 生産(作業)性向上	☒ 質量低減(軽量化・小型化) ☐ 自動運転・安全 ☒ 品質/性能向上 ☐ その他()	・産業機器 ・医療機器 ・事務機器 ・無停電電源 ・通信機器 ・基幹装置 ・充電器			
従来		新技術・新工法			
部品面  基板サイズ: 130 × 108 ■トランス ・リーケージインダクタンスをトランス内部 サイズ: EER40/44.8(46.5 × 43 × H35) 通常実装 ■制御回路 ■チップ部品 ・3216、2125、1608 サイズ主体 ■基板 2層 ■PFC回路の電力デバイス ・表面実装部品へ変更		部品面  基板サイズ: 127 × 71 ■トランス ・リーケージインダクタンスをトランス外部 サイズ: PQ35/20(35 × 14 × H29) サイズ: PQ20/16(22 × 12 × H17) 実装面積 40%低減 ■制御回路 ・HIC基板、モジュール化にてメイン基板 ■チップ部品 ・1608、1005 サイズ主体 ■基板 4層 ■半導体の放熱 ヒートシンクから装置の筐体へ 装置の内容を把握する事で放熱板を			
半田面 		半田面 			
セールスポイント(製造可能な精度/材質等) - 豊富な技術でお客様のニーズに合ったカスタム電源提案 - 電源専門メーカーだから、長期供給と長期サポート - 回路設計、基板設計、構造設計、ソフト設計、意匠設計自社で一括対応		問題点(課題)と対応方法 - 開発イニシャル費・・・台数、市場性により相談 - 開発期間・・・企画段階よりサポート			
開発進度 (2020年 4月 現在) ☒ アイデア段階 ☐ 試作/実験段階 ☐ 開発完了段階 ☐ 製品化完了段階		パテント有無 無			
従来との比較	項目	コスト	質量	生産/作業性	その他(実装面積・体積)
	数値割合	-	小型化	-	面積 35%削減 体積 45%削減